



2022年3月期 第1四半期決算短信(日本基準)(連結)

2021年8月16日

上場会社名 東京エレクトロン株式会社

上場取引所 東

コード番号 8035 URL <https://www.tel.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 河合 利樹

問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 松村 晃文

TEL 03-5561-7000

四半期報告書提出予定日 2021年8月16日

配当支払開始予定日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2022年3月期第1四半期の連結業績(2021年4月1日～2021年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2022年3月期第1四半期	452,049	43.6	141,791	92.0	142,630	89.9	100,363	77.8
2021年3月期第1四半期	314,823	45.5	73,849	73.6	75,089	68.4	56,452	77.0

(注) 包括利益 2022年3月期第1四半期 110,712百万円 (60.1%) 2021年3月期第1四半期 69,131百万円 (155.4%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2022年3月期第1四半期	645.20	641.70
2021年3月期第1四半期	362.98	360.87

(注) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、2022年3月期第1四半期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。増減率は適用前の前年同四半期の連結業績を基礎に算定しております。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2022年3月期第1四半期	1,450,835	1,072,005	72.9
2021年3月期	1,425,364	1,024,562	71.1

(参考) 自己資本 2022年3月期第1四半期 1,057,259百万円 2021年3月期 1,012,977百万円

(注) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、2022年3月期第1四半期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2021年3月期		360.00		421.00	781.00
2022年3月期					
2022年3月期(予想)		562.00		627.00	1,189.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

3. 2022年3月期の連結業績予想(2021年4月1日～2022年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	900,000	34.7	245,000	66.2	245,000	65.3	175,000	56.2	1,124.99
通期	1,850,000	32.2	508,000	58.4	508,000	57.7	370,000	52.3	2,378.53

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、上記の連結業績予想は当該会計基準等を適用した後の数値となっております。増減率は適用前の前期及び前年同四半期の連結業績を基礎に算定しております。

注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

詳細は、「添付資料」10ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有

以外の会計方針の変更 : 無

会計上の見積りの変更 : 無

修正再表示 : 無

詳細は、「添付資料」10ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)」をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)

2022年3月期1Q	157,210,911 株	2021年3月期	157,210,911 株
------------	---------------	----------	---------------

期末自己株式数

2022年3月期1Q	1,651,904 株	2021年3月期	1,659,611 株
------------	-------------	----------	-------------

期中平均株式数(四半期累計)

2022年3月期1Q	155,555,388 株	2021年3月期1Q	155,526,131 株
------------	---------------	------------	---------------

(注) 期末自己株式数には、「役員報酬BIP信託」及び「株式付与ESOP信託」が保有する当社株式(2022年3月期1Q 614,858株、2021年3月期 615,237株)を含めております。また、各信託が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、「添付資料」5ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(4) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

・当社は、2021年8月16日に機関投資家・アナリスト向けにウェブ説明会を開催する予定です。この説明会で使用する決算説明資料につきましては、当社ホームページに掲載する予定です。

【添付資料】

[目次]

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) キャッシュ・フローに関する説明	4
(4) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	5
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	6
(1) 四半期連結貸借対照表	6
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	8
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	10
(継続企業の前提に関する注記)	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	10
(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)	10
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	10
(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)	10
(セグメント情報等)	11

1. 当四半期決算に関する定性的情報

当第1四半期連結会計期間より、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しております。経営成績、財政状態及びキャッシュ・フローに関する説明における前年同期及び前連結会計年度末との比較は、当該会計基準等を適用する前の前連結会計年度の連結業績を基礎に算定しております。

詳細については、「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)」をご参照ください。

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間の世界経済につきましては、新型コロナウイルスの感染蔓延による影響は見られるものの、各国の経済政策の効果等により、全体として回復傾向にありました。

当社グループの参画しておりますエレクトロニクス産業におきましては、IoT、AI、5G等の情報通信技術の用途の拡がりによるデータ社会への移行を背景とした半導体需要の高まりに伴い、半導体製造装置市場の拡大が加速しております。今後も新型コロナウイルスの影響を注視する必要がありますが、半導体製造装置市場は、さらなる成長が見込まれております。

このような状況のもと、当社グループの当第1四半期連結累計期間の連結業績は、売上高4,520億4千9百万円(前年同期比43.6%増)、営業利益1,417億9千1百万円(前年同期比92.0%増)、経常利益1,426億3千万円(前年同期比89.9%増)、また、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,003億6千3百万円(前年同期比77.8%増)となりました。

セグメント別の概況は以下のとおりです。

① 半導体製造装置

ロジック/ファウンドリ向け半導体に対する設備投資は、あらゆるアプリケーション向けの半導体デバイスの世界的な需要増を受け、最先端から成熟世代まで、広い範囲での投資が堅調に推移しました。加えて、DRAM向け設備投資においても、昨年末から今年年初にかけて需給バランスが改善し、前四半期に引き続き、旺盛な投資が継続しました。また、前年度において大きく回復したNANDフラッシュメモリ向け設備投資は、当年度においても、引き続き高い投資水準となりました。このような状況のもと、当セグメントの当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、4,379億2千4百万円(前年同期比44.2%増)となりました。

② FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置

テレビ用大型液晶パネル向け設備投資が一巡したことにより、FPD TFTアレイ向け製造装置市場全体としては減速傾向となりました。一方、中小型有機ELパネル向け設備投資については、前四半期に引き続き、高いレベルで推移しました。最終製品に搭載されるディスプレイが液晶から有機ELへと転換される中、モバイル等、中小型ディスプレイの需要が増加しております。このような状況のもと、当セグメントの当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、140億9千万円(前年同期比27.9%増)となりました。

③ その他

当セグメントの当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、3千5百万円(前年同期比4.9%減)となりました。

(ご参考)

【連結業績】

(単位：百万円)

	前期通期				当期第1Q	
	前期第1Q	前期第2Q	前期第3Q	前期第4Q		
売上高	1,399,102	314,823	353,337	291,725	439,216	452,049
半導体製造装置	1,315,200	303,772	331,684	264,305	415,438	437,924
日本	195,821	49,150	56,852	36,149	53,669	54,861
北米	152,057	42,343	44,009	34,501	31,202	43,911
欧州	63,502	15,774	16,311	12,797	18,619	13,411
韓国	279,938	67,013	72,199	39,318	101,407	95,304
台湾	245,637	50,926	53,914	52,513	88,283	62,853
中国	325,844	73,957	79,123	70,541	102,222	153,684
東南アジア他	52,397	4,605	9,274	18,483	20,033	13,897
FPD製造装置	83,772	11,013	21,623	27,388	23,747	14,090
その他	129	37	29	31	31	35
営業利益	320,685	73,849	73,579	62,868	110,388	141,791
経常利益	322,103	75,089	73,138	62,424	111,451	142,630
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	242,941	56,452	55,559	46,167	84,761	100,363

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ70億3千万円増加し、1兆227億2千7百万円となりました。主な内容は、受取手形、売掛金及び契約資産の増加623億1千3百万円、現金及び預金の増加351億8千9百万円、未収消費税等の減少580億6百万円、棚卸資産の減少283億9千5百万円によるものであります。

有形固定資産は、前連結会計年度末から34億5千万円増加し、2,004億1千8百万円となりました。

無形固定資産は、前連結会計年度末から13億6千1百万円増加し、185億2千5百万円となりました。

投資その他の資産は、前連結会計年度末から136億2千8百万円増加し、2,091億6千4百万円となりました。

これらの結果、総資産は、前連結会計年度末から254億7千1百万円増加し、1兆4,508億3千5百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ246億円減少し、3,030億6千万円となりました。主として、賞与引当金の減少168億2千5百万円、前受金の減少87億2千2百万円によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ26億2千9百万円増加し、757億6千9百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ474億4千2百万円増加し、1兆720億5百万円となりました。主として、親会社株主に帰属する四半期純利益1,003億6千3百万円を計上したことによる増加、前期の期末配当657億4千6百万円の実施による減少、その他有価証券評価差額金の増加84億3千7百万円によるものであります。この結果、自己資本比率は72.9%となりました。

(3) キャッシュ・フローに関する説明

現金及び現金同等物の当第1四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ351億3千3百万円増加し、3,011億2千6百万円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資406億1千6百万円を加えた残高は、前連結会計年度末に比べ301億8千9百万円増加し、3,417億4千2百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、前年同期に比べ585億5百万円増加の1,112億8千9百万円の収入となりました。主な要因につきましては、税金等調整前四半期純利益1,380億3千3百万円、未収消費税等の減少580億1千8百万円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、法人税等の支払額439億5千1百万円、棚卸資産の増加205億7千8百万円、賞与引当金の減少168億6千7百万円がそれぞれキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主として有形固定資産の取得による支出119億2千4百万円により、前年同期の148億9千1百万円の収入に対し107億6千2百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に配当金の支払657億4千6百万円により、前年同期の535億3千万円の支出に対し659億8千1百万円の支出となりました。

【連結キャッシュ・フロー(要約)】

(単位：百万円)

	前第1四半期 連結累計期間	当第1四半期 連結累計期間
営業活動によるキャッシュ・フロー	52,784	111,289
税金等調整前四半期純利益	74,667	138,033
減価償却費	7,152	7,934
売上債権及び前受金の増減額	11,452	—
売上債権及び契約資産、前受金の増減額	—	△21,140
棚卸資産の増減額(△は増加)	△22,694	△20,578
仕入債務の増減額(△は減少)	880	△784
その他	△18,674	7,825
投資活動によるキャッシュ・フロー	14,891	△10,762
定期預金及び短期投資の増減額(△は増加)	30,000	4,955
その他(固定資産の取得等)	△15,108	△15,718
財務活動によるキャッシュ・フロー	△53,530	△65,981
現金及び現金同等物に係る換算差額	100	587
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	14,245	35,133
現金及び現金同等物の期首残高	247,959	265,993
現金及び現金同等物の四半期末残高	262,204	301,126
現金及び現金同等物並びに満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資の四半期末残高	322,656	341,742

(4) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

IoT、AI、5G等の情報通信技術の用途の拡がりによるデータ社会への移行を背景とした半導体需要の高まりに伴い、半導体製造装置市場の拡大が加速しており、第2四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきまして、最新の顧客の設備投資動向と業績動向に鑑み、2021年4月30日に公表した数値を以下のとおり修正いたします。

2022年3月期第2四半期累計期間の連結業績予想

	今回修正予想	前回予想 (2021年4月30日公表)
売上高	9,000億円 (前年同期比 34.7%増)	8,400億円
半導体製造装置	8,740億円 (前年同期比 37.5%増)	8,140億円
F P D製造装置	260億円 (前年同期比 20.3%減)	260億円
営業利益	2,450億円 (前年同期比 66.2%増)	2,180億円
経常利益	2,450億円 (前年同期比 65.3%増)	2,180億円
親会社株主に帰属する 四半期純利益	1,750億円 (前年同期比 56.2%増)	1,630億円

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

2022年3月期通期の連結業績予想

	今回修正予想	前回予想 (2021年4月30日公表)
売上高	1兆8,500億円 (前期比 32.2%増)	1兆7,000億円
半導体製造装置	1兆7,930億円 (前期比 36.3%増)	1兆6,430億円
F P D製造装置	570億円 (前期比 32.0%減)	570億円
営業利益	5,080億円 (前期比 58.4%増)	4,420億円
経常利益	5,080億円 (前期比 57.7%増)	4,420億円
親会社株主に帰属する 当期純利益	3,700億円 (前期比 52.3%増)	3,300億円

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

※この決算短信に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否、並びに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	186,538	221,727
受取手形及び売掛金	191,700	—
受取手形、売掛金及び契約資産	—	254,013
有価証券	125,014	120,014
商品及び製品	269,772	196,337
仕掛品	80,742	121,326
原材料及び貯蔵品	64,828	69,284
その他	97,197	40,128
貸倒引当金	△99	△105
流動資産合計	1,015,696	1,022,727
固定資産		
有形固定資産	196,967	200,418
無形固定資産		
その他	17,163	18,525
無形固定資産合計	17,163	18,525
投資その他の資産		
その他	196,943	210,573
貸倒引当金	△1,407	△1,409
投資その他の資産合計	195,536	209,164
固定資産合計	409,667	428,108
資産合計	1,425,364	1,450,835

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	90,606	90,182
未払法人税等	49,272	41,479
前受金	81,722	72,999
製品保証引当金	14,415	18,236
賞与引当金	34,254	17,429
その他の引当金	2,872	928
その他	54,516	61,804
流動負債合計	327,661	303,060
固定負債		
その他の引当金	3,834	4,134
退職給付に係る負債	62,137	61,636
その他	7,167	9,998
固定負債合計	73,140	75,769
負債合計	400,801	378,830
純資産の部		
株主資本		
資本金	54,961	54,961
資本剰余金	78,011	78,011
利益剰余金	835,240	869,046
自己株式	△30,744	△30,616
株主資本合計	937,468	971,402
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	66,124	74,562
繰延ヘッジ損益	△79	△19
為替換算調整勘定	10,441	12,119
退職給付に係る調整累計額	△978	△805
その他の包括利益累計額合計	75,508	85,857
新株予約権	11,585	14,746
純資産合計	1,024,562	1,072,005
負債純資産合計	1,425,364	1,450,835

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
売上高	314,823	452,049
売上原価	186,325	241,118
売上総利益	128,497	210,931
販売費及び一般管理費		
研究開発費	30,142	34,356
その他	24,505	34,783
販売費及び一般管理費合計	54,648	69,140
営業利益	73,849	141,791
営業外収益		
受取配当金	737	841
持分法による投資利益	152	588
その他	672	351
営業外収益合計	1,562	1,781
営業外費用		
為替差損	154	683
アレンジメントフィー	100	—
その他	67	258
営業外費用合計	322	942
経常利益	75,089	142,630
特別利益		
固定資産売却益	13	0
特別利益合計	13	0
特別損失		
固定資産除売却損	435	20
付加価値税追徴税額	—	4,577
特別損失合計	435	4,597
税金等調整前四半期純利益	74,667	138,033
法人税等	18,214	37,669
四半期純利益	56,452	100,363
親会社株主に帰属する四半期純利益	56,452	100,363

四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
四半期純利益	56,452	100,363
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	12,340	8,437
繰延ヘッジ損益	△8	—
為替換算調整勘定	207	1,663
退職給付に係る調整額	163	178
持分法適用会社に対する持分相当額	△24	68
その他の包括利益合計	12,678	10,348
四半期包括利益	69,131	110,712
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	69,131	110,712

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

税金費用の計算

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)

会計方針の変更

① 収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2020 年 3 月 31 日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第 1 四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

半導体製造装置及び FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置の販売において、主として、従来は、装置の引渡と装置の設置に関連する役務の提供を単一の履行義務として識別し、装置の設置が完了した時点で収益を認識しておりましたが、この適用により、装置の引渡と装置の設置に関連する役務の提供を別個の履行義務として識別し、装置の引渡が完了し履行義務が充足された時点、及び装置の設置に関連する役務の提供が完了し履行義務が充足された時点で、収益を認識することとしました。

また、同一の顧客に対して一定量以上の装置等を販売する場合、顧客の購入数量等に応じて、特別価格での取引を行うことがあります。これらの関連する取引において、従来は個々の受注額に基づいて収益を認識しておりましたが、将来の購入数量等によって取引全体の対価が変動するため、当該特別価格を変動対価として見積り、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに認識された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、取引価格に含めることとしました。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第 84 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第 1 四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第 1 四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当第 1 四半期連結累計期間の売上高は 139,567 百万円増加し、売上原価は 56,672 百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ 82,894 百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は 753 百万円減少しております。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当第 1 四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示しております。なお、収益認識会計基準第 89-2 項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。

② 時価の算定に関する会計基準等の適用

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

(セグメント情報等)

① 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、BU(ビジネスユニット)を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「半導体製造装置」及び「FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置」を報告セグメントとしております。

「半導体製造装置」の製品は、ウェーハ処理工程で使われるコータ/デベロッパ、エッチング装置、成膜装置、洗浄装置、ウェーハ検査工程で使われるウェーハプローバ、及びウェーハレベルのボンディング/デボンディング装置などの半導体製造装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「FPD製造装置」の製品は、フラットパネルディスプレイ製造用のコータ/デベロッパ、エッチング/アッシング装置及び有機ELディスプレイ製造用インクジェット描画装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

② 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)

(単位:百万円)

	報告セグメント		その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 3
	半導体 製造装置	FPD 製造装置				
売上高	437,924	14,090	6,234	458,248	△6,199	452,049
セグメント利益	152,886	1,666	131	154,684	△16,651	138,033

(注) 1. 「その他」は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループの物流・施設管理・保険業務等であります。

2. セグメント利益の調整額△16,651百万円は、報告セグメントに帰属しない当社における基礎研究又は要素研究等の研究開発費△5,109百万円、及びその他の一般管理費等であります。

3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益と調整を行っております。

③ 報告セグメントの変更等に関する事項

(収益認識に関する会計基準等の適用)

(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示) 会計方針の変更 ①収益認識に関する会計基準等の適用に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に變更しております。

この結果、従来の方法に比べて、当第1四半期連結累計期間におけるセグメントごとの売上高は、「半導体製造装置」で141,944百万円増加し、「FPD製造装置」で2,377百万円減少しております。また、セグメント利益は、「半導体製造装置」で83,327百万円増加し、「FPD製造装置」で433百万円減少しております。

④ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。